

臻鼎科技控股 (4958 TT)

投資人簡報

2025年06月



免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

一分鐘認識臻鼎



全球第1大

印刷電路板製造公司

2006年 成立
(前身華虹電子 1978)

48,141
2024年底員工數



台灣桃園 總部



29 座工廠

位於大陸、台灣、泰國、
印度

NT\$1,716.6億

2024年營收(13.4% YoY)

NT\$990億

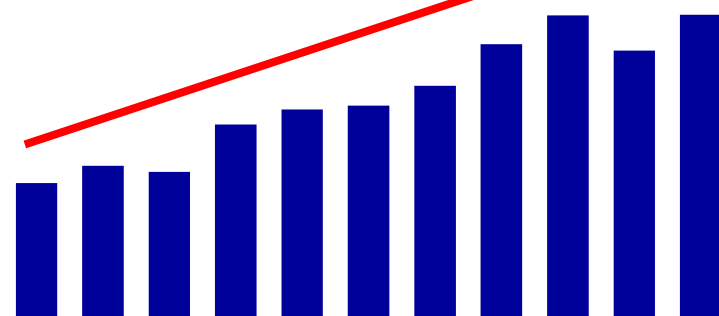
2025年5月12日市值

13.3%

10年平均股東權益報酬率
(2015-2024)

+9%

2014-2024年
營收年複合成長率



1,868

累計有效獲證專利件數

3,866

累計專利申請

(截至2024年12月底)

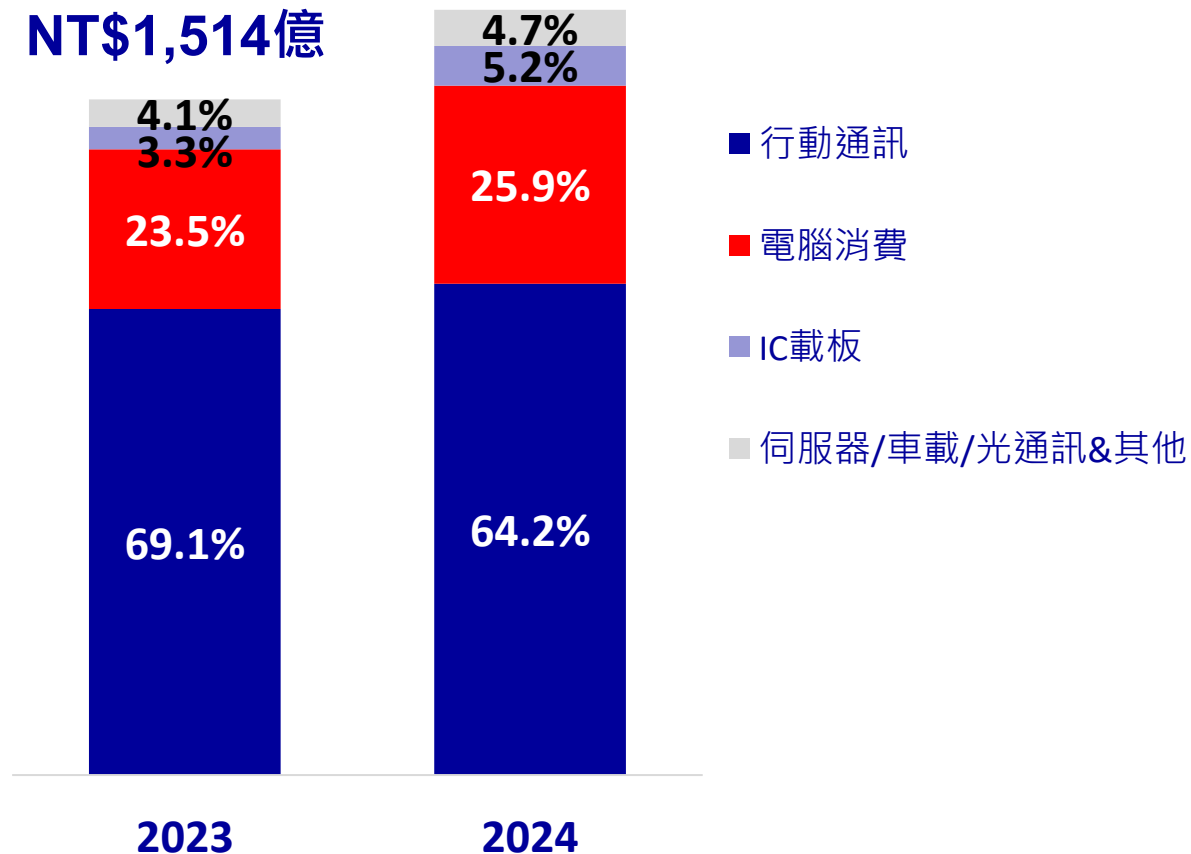


銷售分析 – 產品應用別

+13.4% YoY

NT\$1,514億

NT\$1,717億



營運成果回顧暨未來展望

1

1Q25營收年增23.3%，刷新歷年同期新高紀錄，同時營業利益年增逾四成

1Q25 在行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/光通訊以及IC載板等四大應用領域皆繳出雙位數成長的亮眼表現，顯示臻鼎多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。

在營運費用控制得宜下，營業利益率較去年同期增加0.3個百分點至2.6%，營業利益年增達42.2%，公司營運效率持續優化。

3

全球產能布局按計畫執行，泰國第一期廠房如期於5/8進入試產

臻鼎於大陸、泰國、高雄及印度佈建全球生產基地，為因應國際貿易風險奠定堅實基礎。

泰國新廠第一期已於5月8日試產，將可支應高階伺服器、車載與光通訊應用相關需求；第二期廠房亦於同日動土。

高雄AI園區之高階ABF載板與RPCB產能建置依計畫推進。泰國與高雄兩大基地的生產效益預期將於2026-2027年起陸續顯現。

2

2025年營收維持「再創新高」目標，以營運韌性因應政策變化與市場波動

美國關稅政策對臻鼎的直接影響有限，公司將持續關注終端需求變化，靈活調度全球產能，確保營運彈性。

隨著邊緣AI裝置（如AI手機、智慧眼鏡、人形機器人、智能車等）需求迅速增長，以及AI伺服器、光通訊與IC載板等高階產品新訂單陸續挹注，預期今年四大應用營收將全面成長。

4

積極佈局前瞻技術，與多家國際客戶展開未來1-2年新產品與新技術的共同開發

在折疊終端與穿戴設備方面，臻鼎憑藉動態彎折FPC模組與超長尺寸FPC組件技術，成為折疊手機、AR/VR、與AI眼鏡等終端裝置的核心供應商。

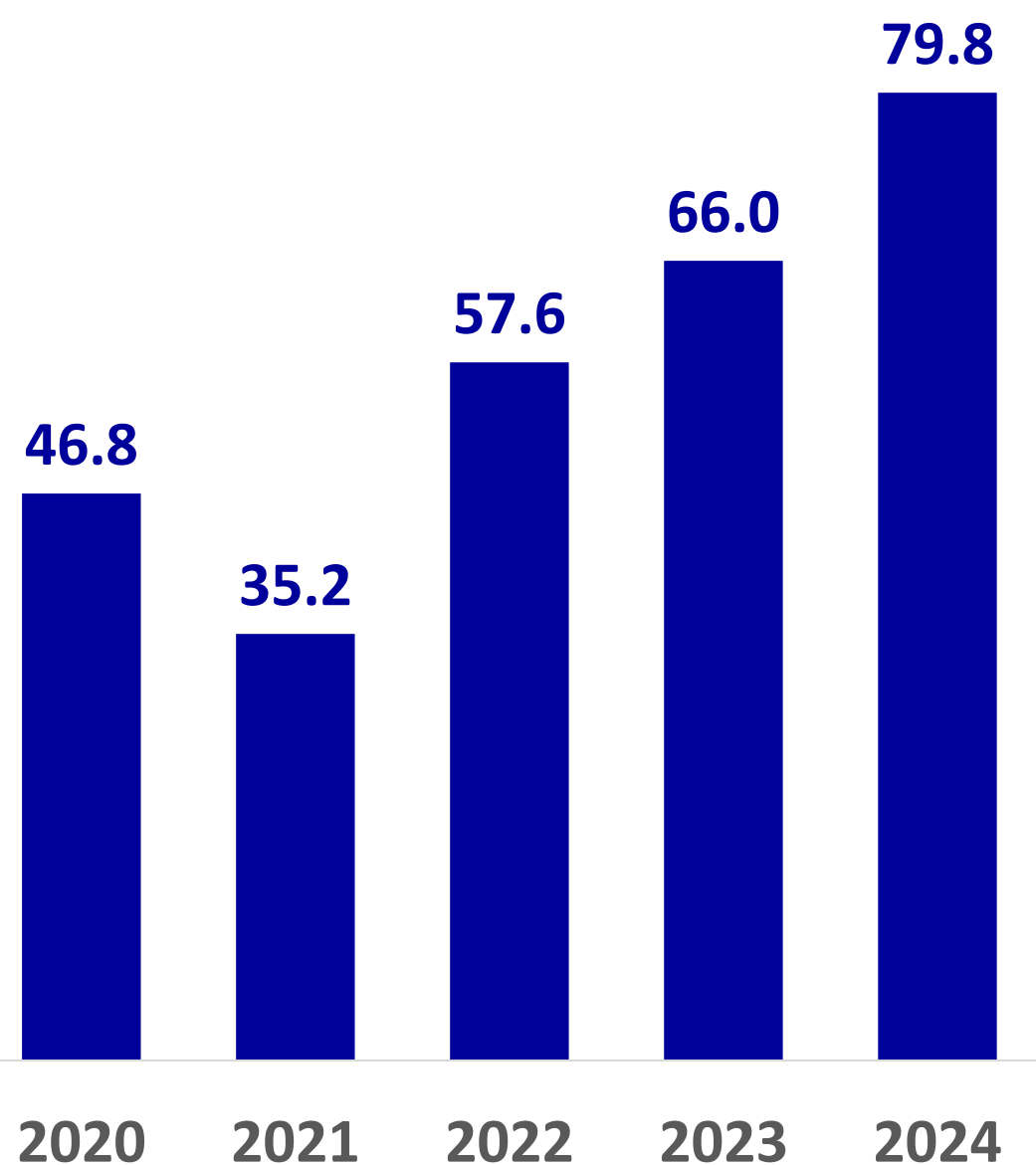
在AI伺服器領域，臻鼎推出支持GPU模組與高速傳輸接口的高階HDI，滿足高算力需求。

在光通訊方面，臻鼎以高階mSAP設計瞄準800G/1.6T光通訊升級窗口，並與客戶合作開發下一代3.2T光通訊解決方案。

充足現金部位，可靈活應對經濟情勢變化

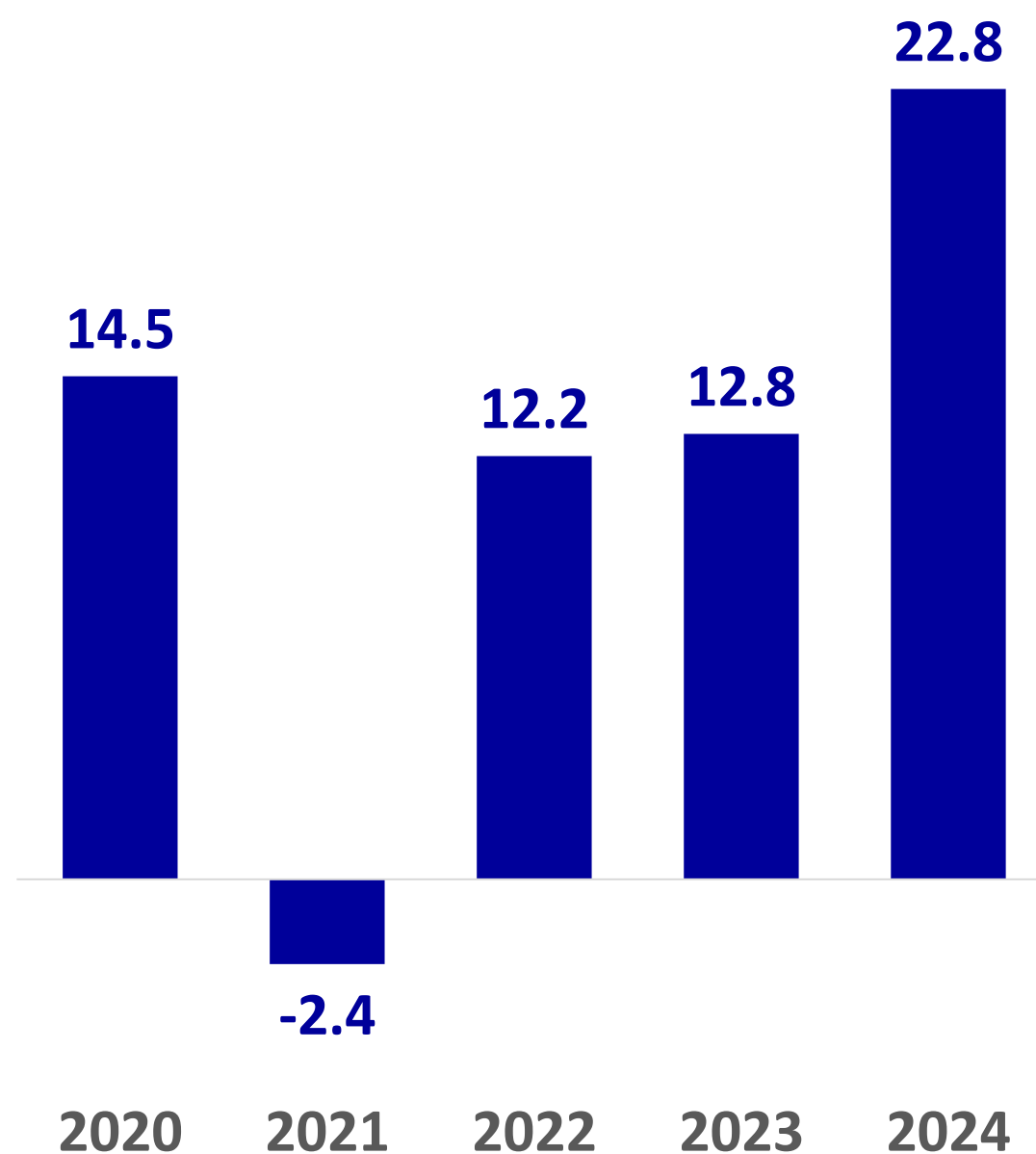
現金及約當現金*

單位：NT\$bn



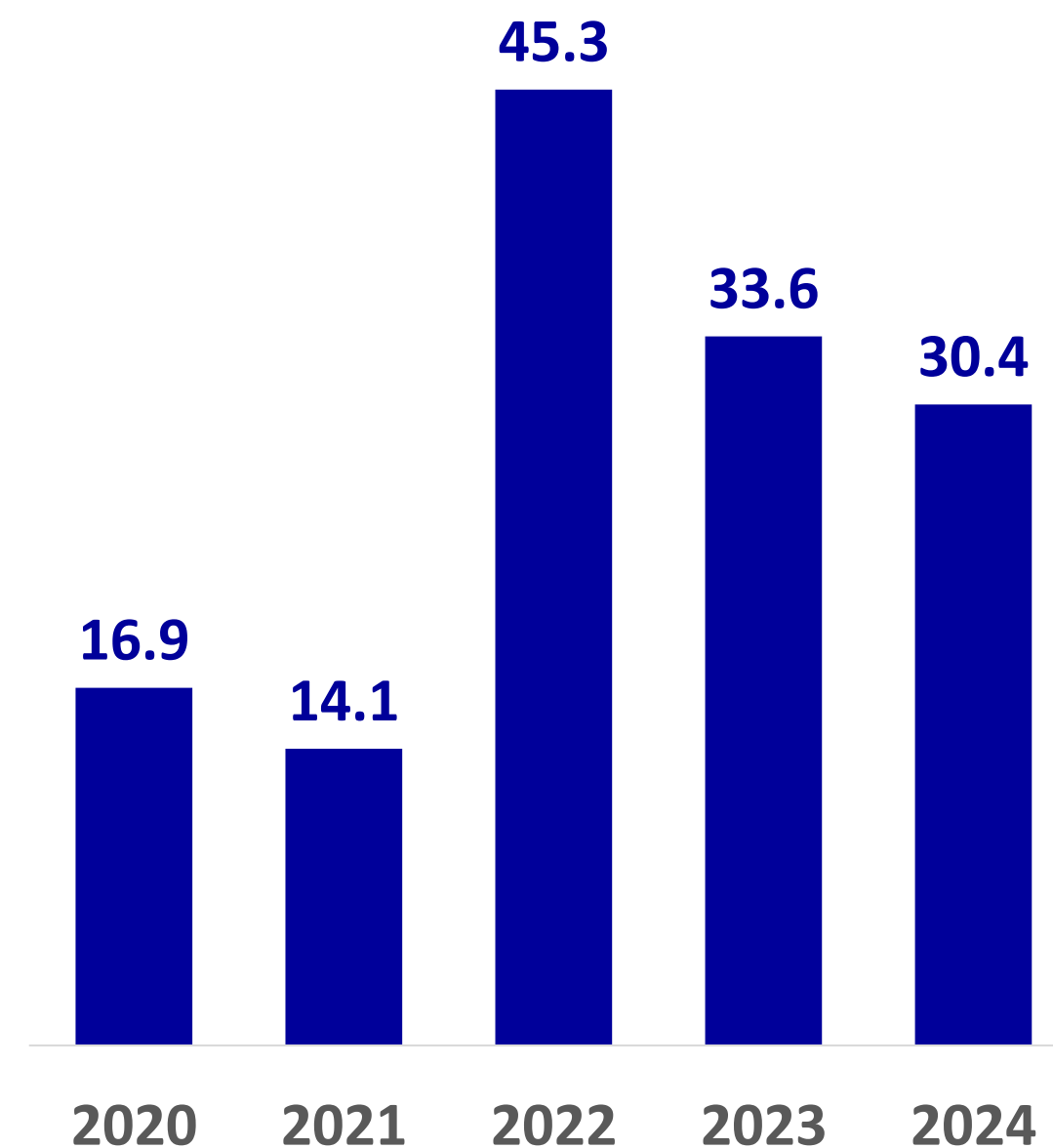
淨現金

單位：NT\$bn




來自營運之現金流量

單位：NT\$bn



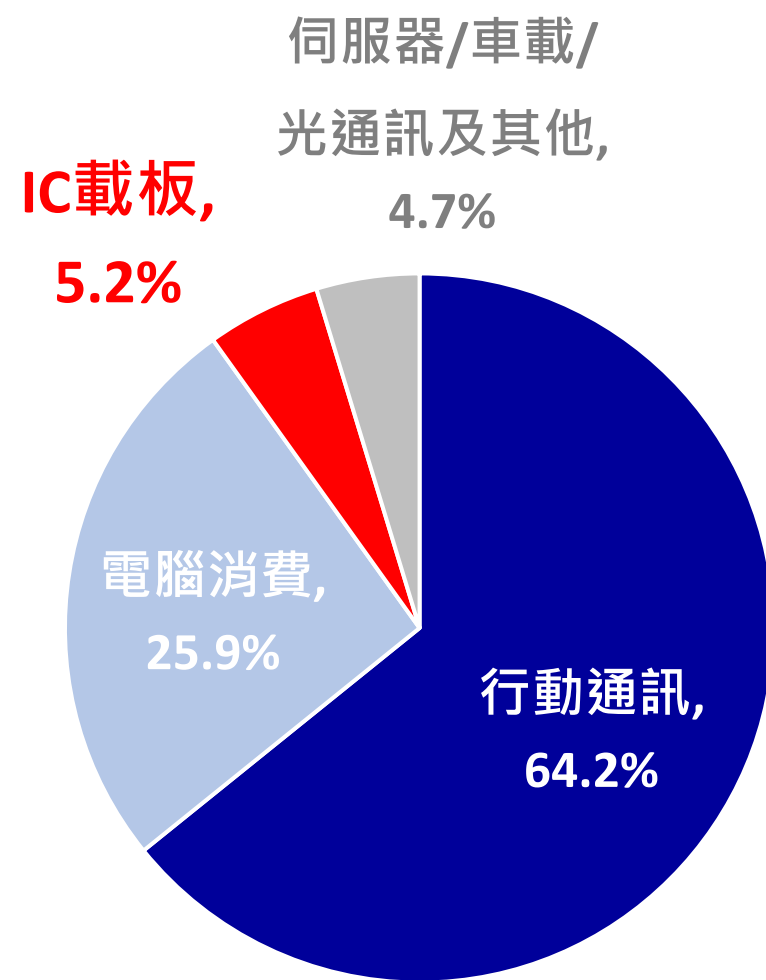
* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



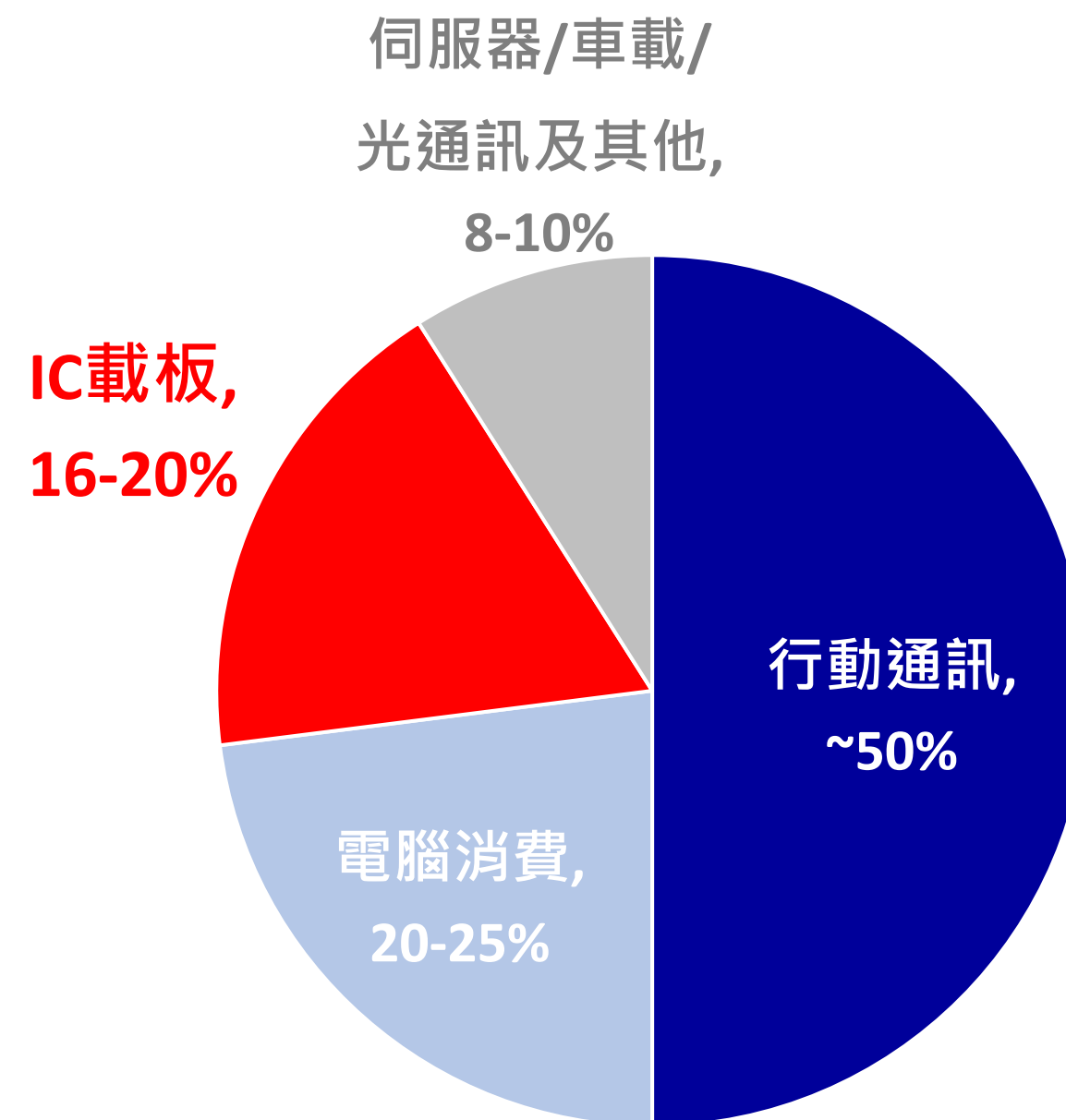
以先進技術領航，
IC載板業務快速成長

穩步推進IC載板佈局，持續擴大營收貢獻

臻鼎：2024年產品應用營收佔比

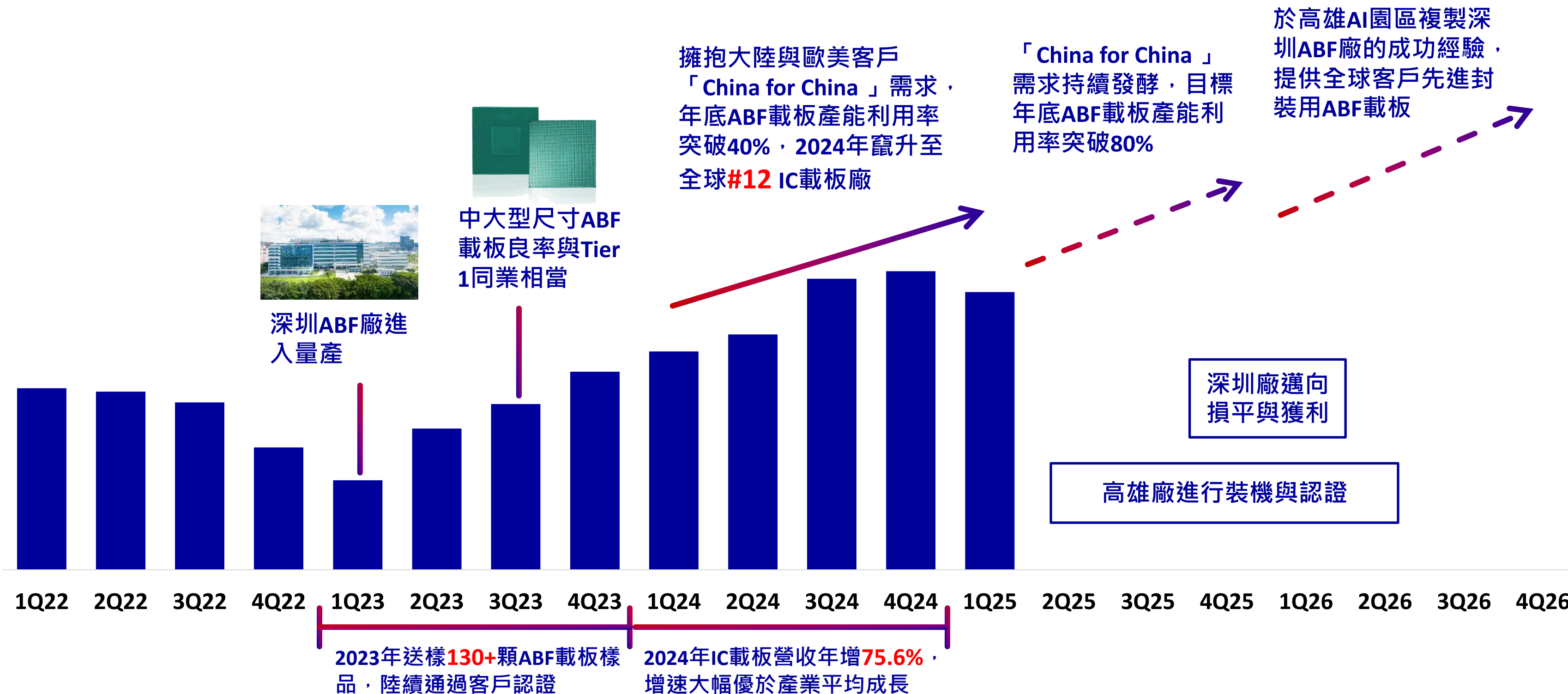


臻鼎：2030年目標產品應用營收佔比



擁抱「China for China」需求， 同時以先進封裝用ABF載板擴大Outside China客戶群

臻鼎IC載板營收趨勢



目標2030年躋身全球前五大IC載板廠

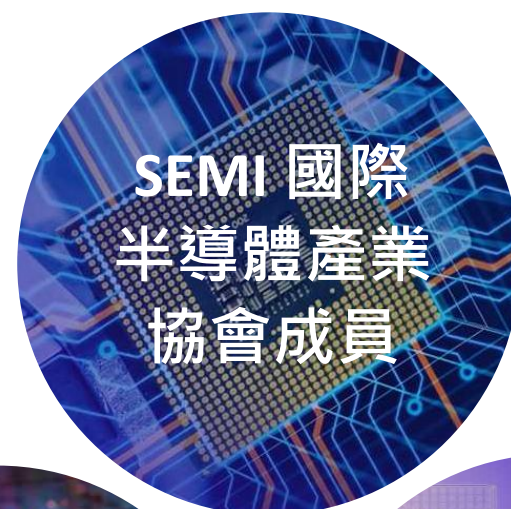
專注高階需求

- 以業界最先進的IC載板生產基地，專注客戶高階需求。
- 受惠於AI、高速運算與先進封裝技術的快速發展，高階ABF載板在大尺寸(70mm*70mm以上)及高層數(16層以上)產品需求持續成長。
- 持續開發新技術平台產品，待客戶認證通過後有望於2H25開始貢獻營收。



串聯半導體產業鏈

- 積極參與半導體產業相關組織，與上下游企業密切合作，拓展在新興技術領域的市場機會。



複製大陸經驗至高雄AI園區

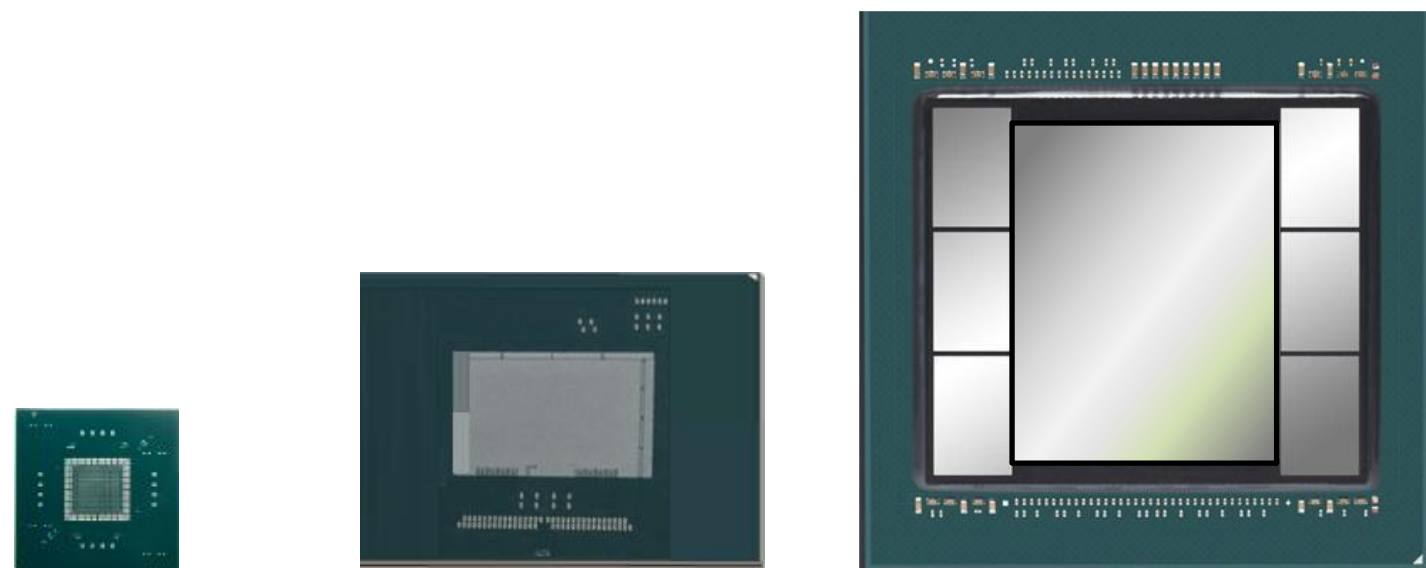
- 大陸廠區以高品質、高良率、高效率深受客戶肯定，產能利用率持續拉升。
- 將複製大陸成功經驗，於高雄AI園區建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域，重點開發分布於亞洲與歐美的指標型半導體客戶。
- 臻鼎為首家進入台灣科學園區的PCB廠，在技術與環保方面符合高標準。



臻鼎ABF載板技術能力與Tier 1競爭者相當， 致力爭取全球領先半導體客戶

ABF載板發展趨勢

層數**高**、尺寸**大**、表面**平**、產品精度**準**



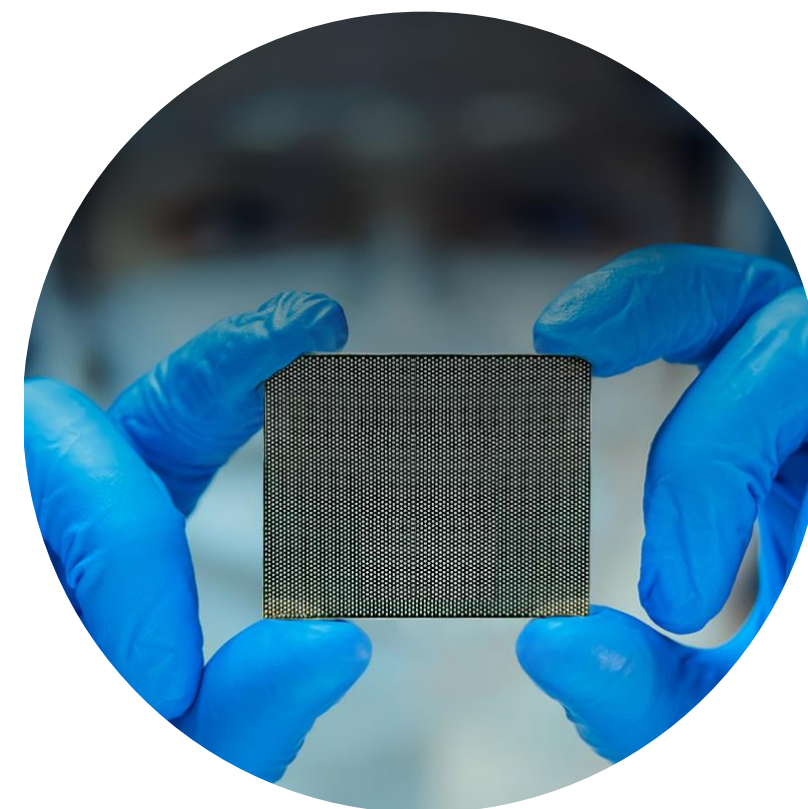
2005

2020

2026

Body Size (mm)	31 x 31	75 x 60	120 x 140+	x20+
Layer count (L)	6	20	28+	x4+
Bump Count	1K	100K	300k+ ~ 500k+	x300+

臻鼎技術能力已達
產業領先水準





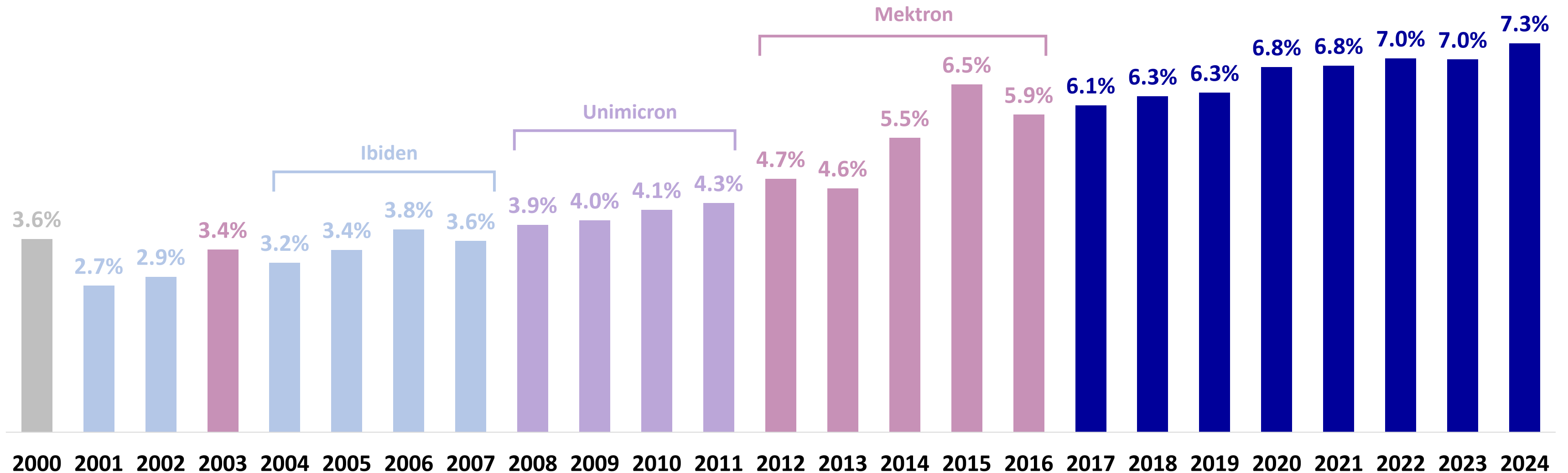
強化領先優勢，
擴大市場版圖

臻鼎持續居於產業領先地位

歷年全球最大PCB廠商市佔率

■ Sanmina ■ Ibiden ■ Mektron ■ UMTC ■ ZDT

臻鼎連續 8 年市佔率全球第一
(且為PCB產業歷年來首家突破7%市佔率的公司)

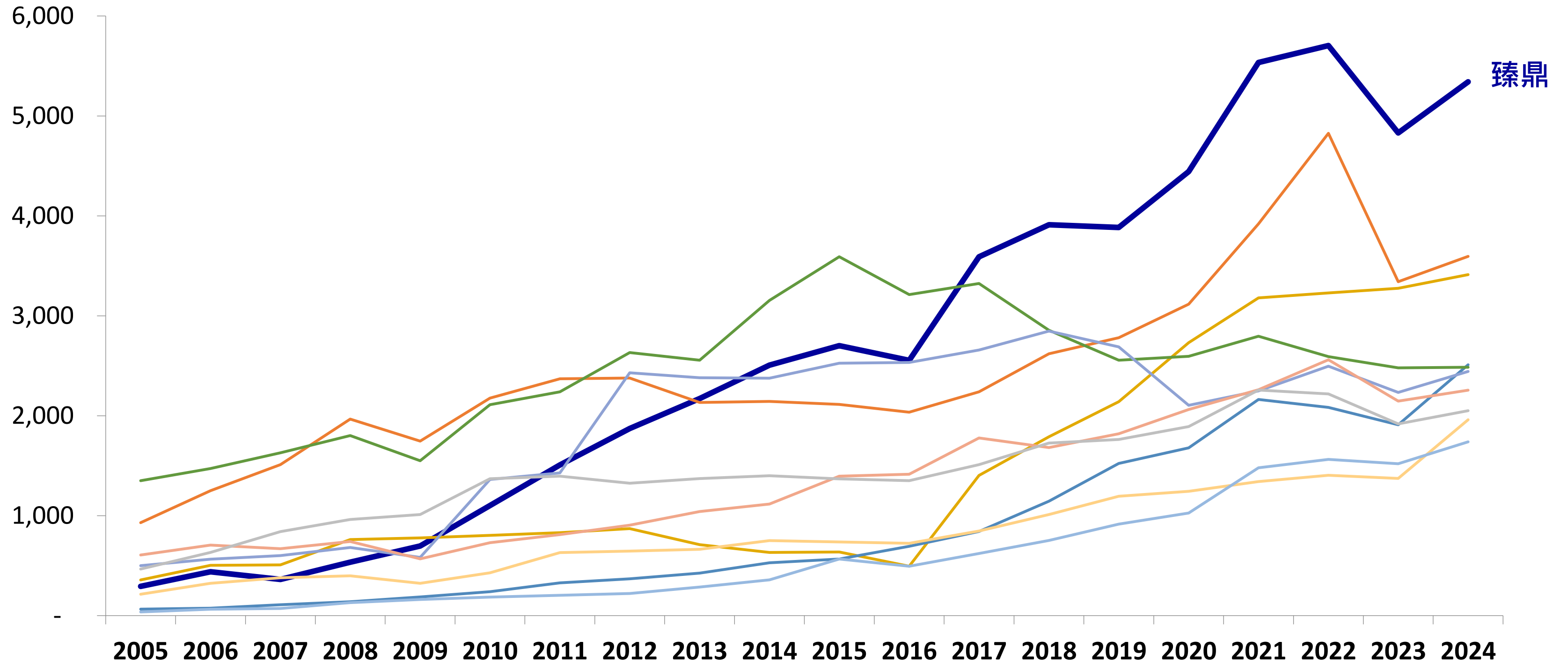


資料來源：Prismark

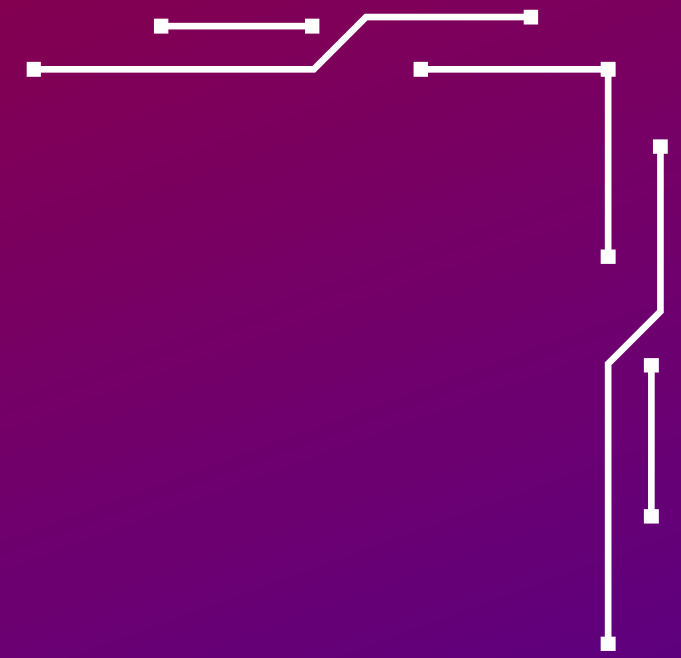
臻鼎保持與同業間的領先差距

2024年全球前十大PCB領導廠商營收趨勢

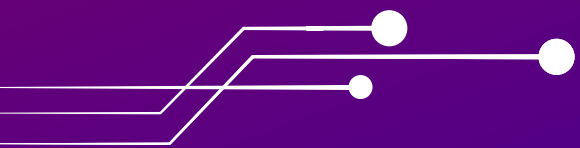
單位：百萬美元



資料來源：NT Information；Prismark (2025/03)



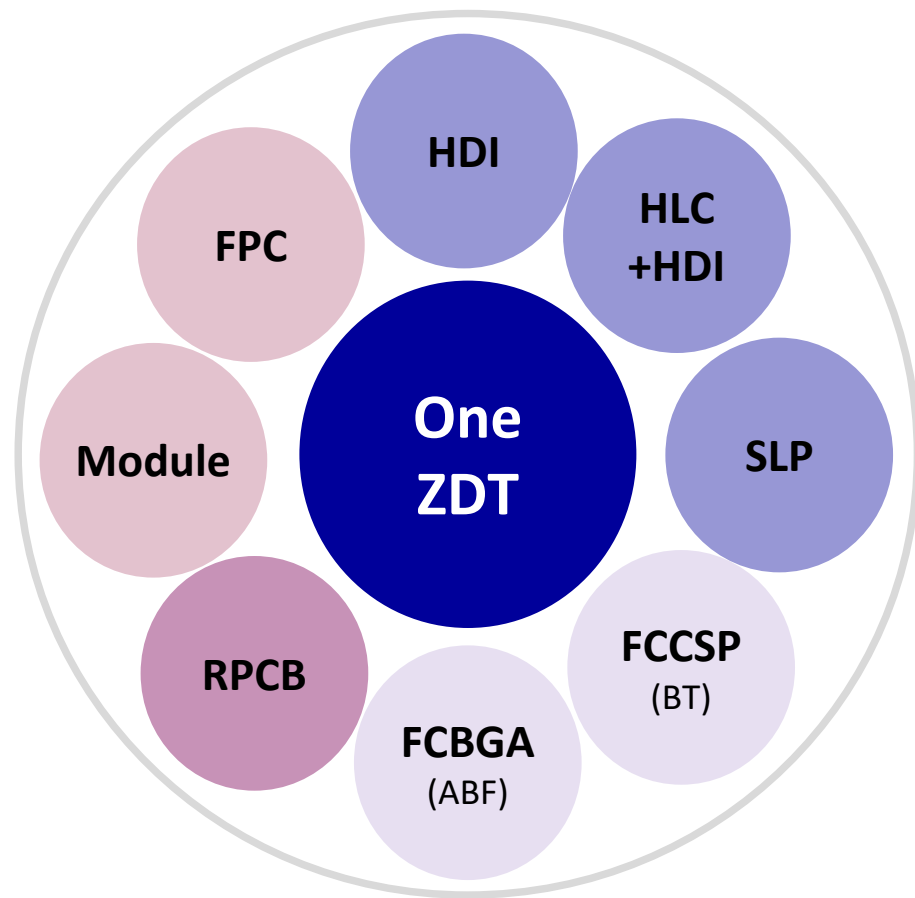
為何臻鼎能持續保持領先地位?



以One ZDT，拉開臻鼎與同業的領先差距

臻鼎：唯一橫跨全產品線的PCB領導者

憑藉One ZDT的全產品布局，臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，提供最完整的解決方案，確保在PCB技術日益複雜的競爭中，穩居全球領導地位。



AI

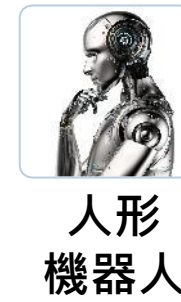
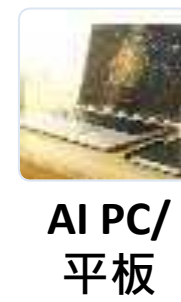
雲



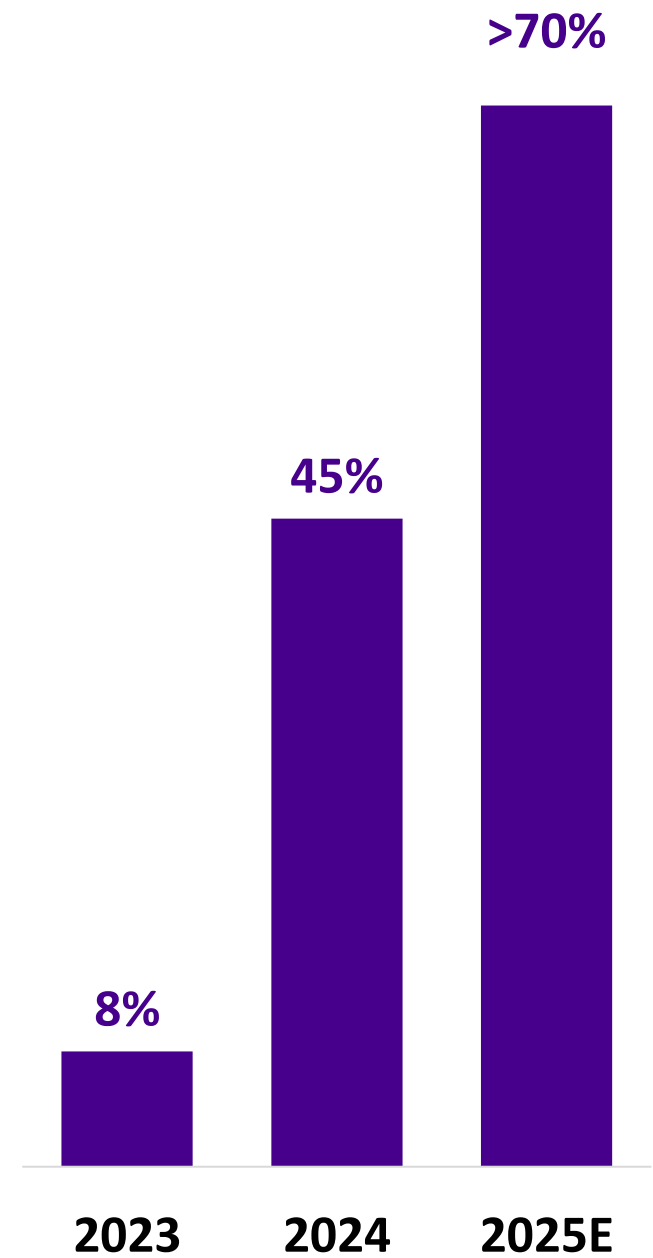
管



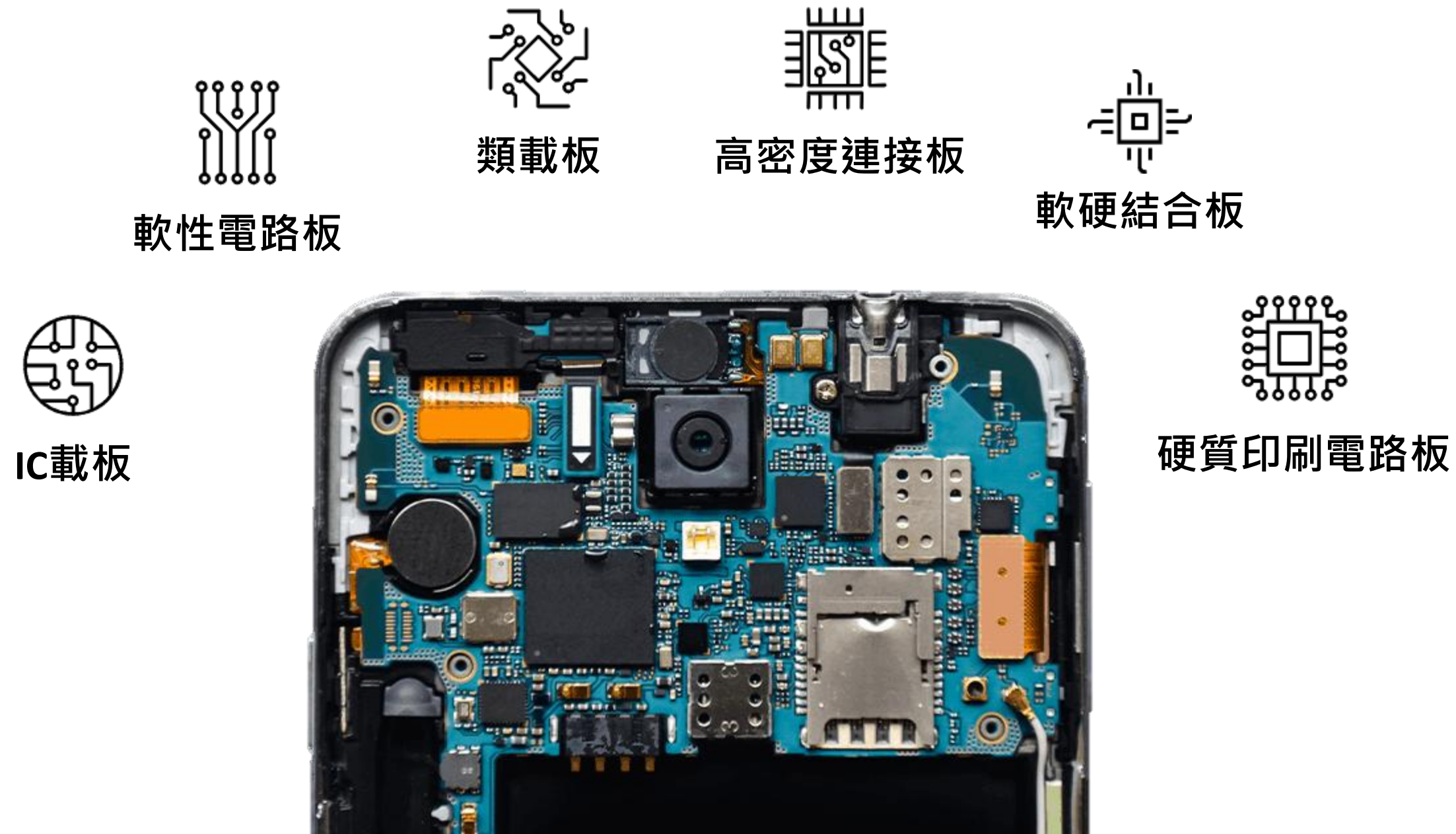
端



■ 臻鼎AI營收占比



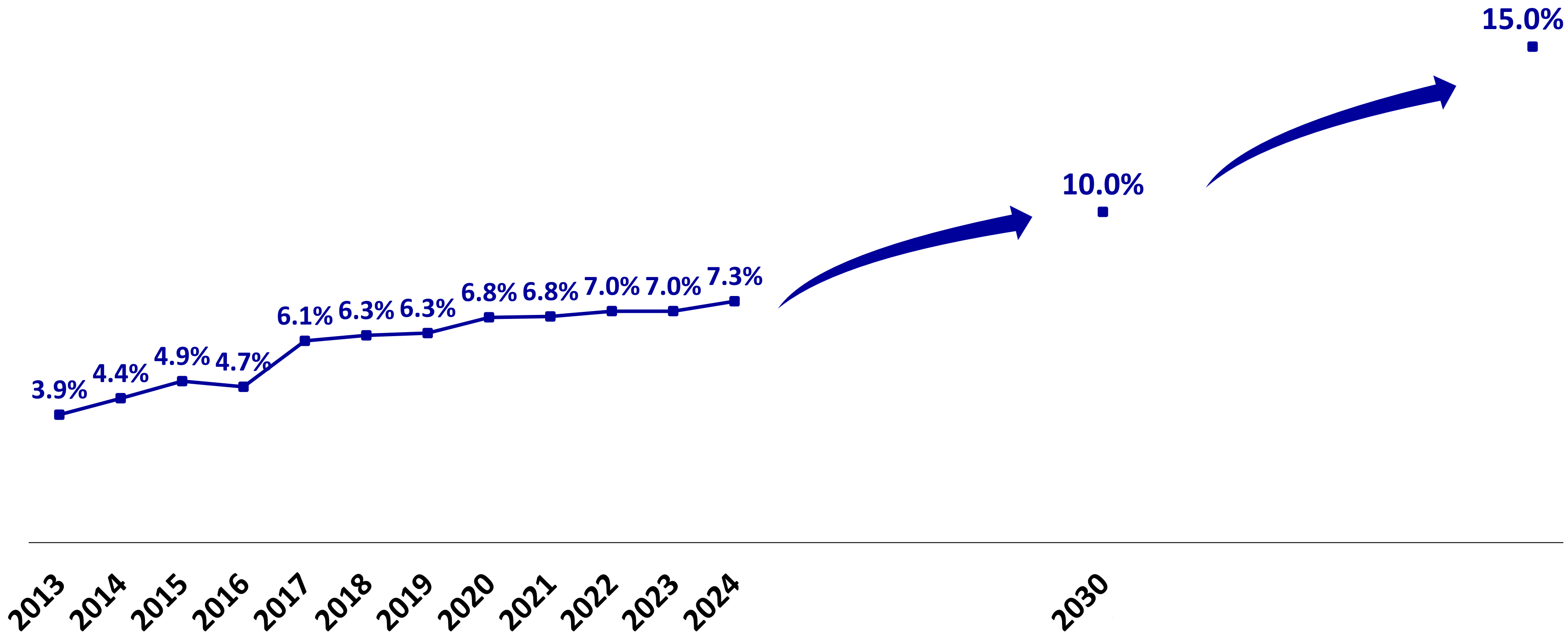
為何One ZDT是關鍵？



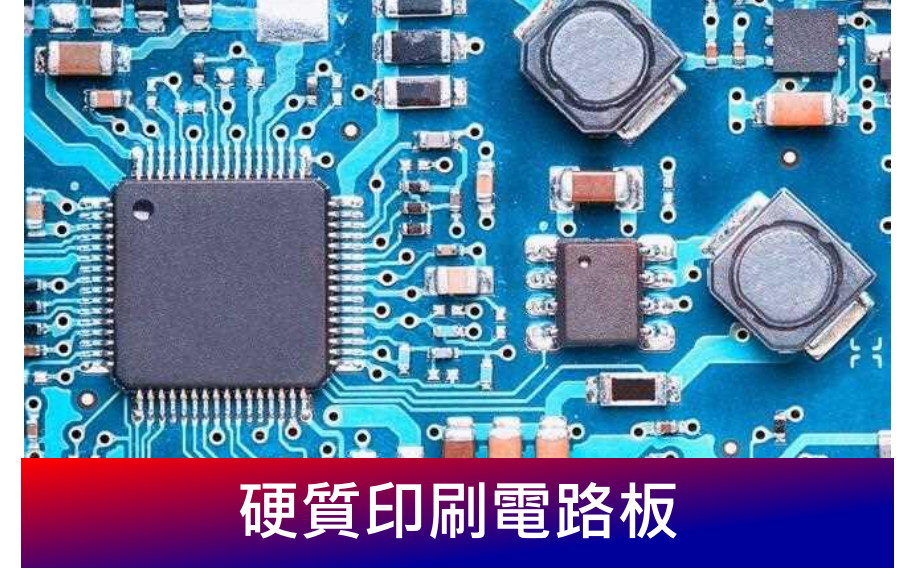
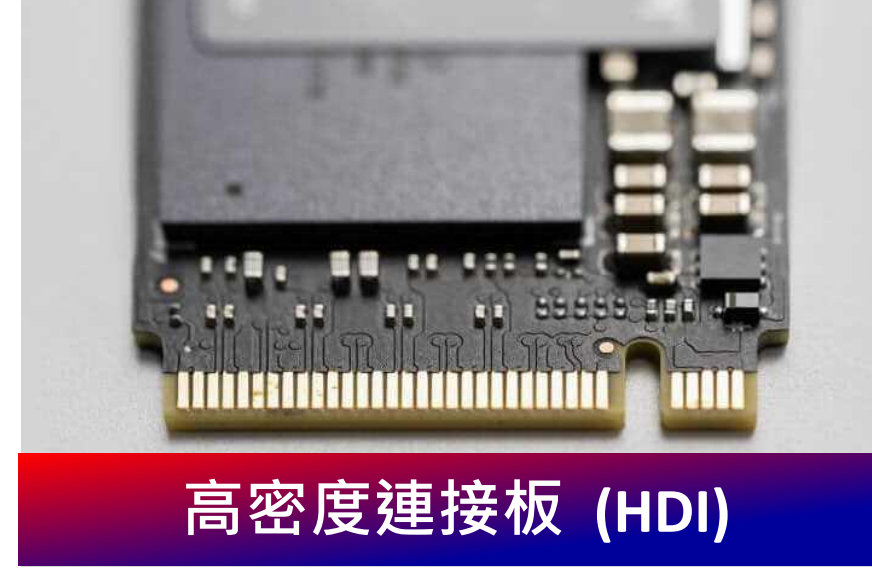
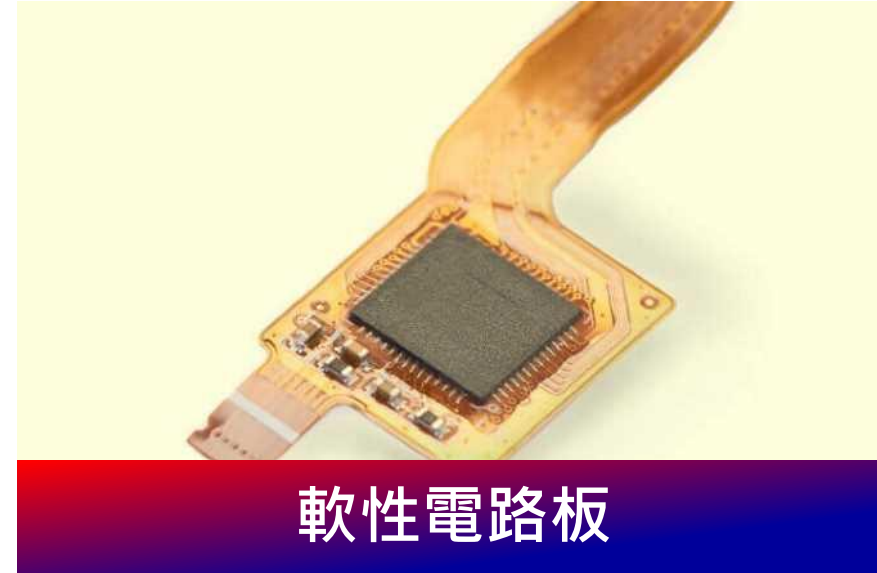
以手機為例，One ZDT可協助客戶優化整體產品設計、
使客戶產品運作更有效率，協助客戶掌握Time-to-Market。

臻鼎目標持續擴張全球PCB市佔率

臻鼎之全球PCB市佔率



四大產品線將持續成長



2030目標

全球前5

2030目標

保持#1

2030目標

全球#1

2030目標

全球前10

深化與客戶及產業鏈夥伴合作，目標每年創造優於產業平均的營收與獲利成長

受惠邊緣AI產品結構設計升級趨勢，推升PCB需求

持續與全球領先客戶合作，開發高階新品，滿足高精度高密度佈線產品需求，鞏固臻鼎在邊緣AI產品的全球領導地位

AI手機/平板/電腦



- 因應AI發展，加速PCB規格升級趨勢。
- 持續與全球領先客戶合作，配合客戶研發包含折疊機等高價值產品。

智慧眼鏡 / VR / AR



- 相關產品需求預期於2025年倍數成長。
- 配合全球領先客戶開發新品，持續扮演重要供應商。

人形機器人



- 人形機器人對PCB的技術要求高，主要用於主控系統、感測器模組、電源管理、關節驅動等核心功能。

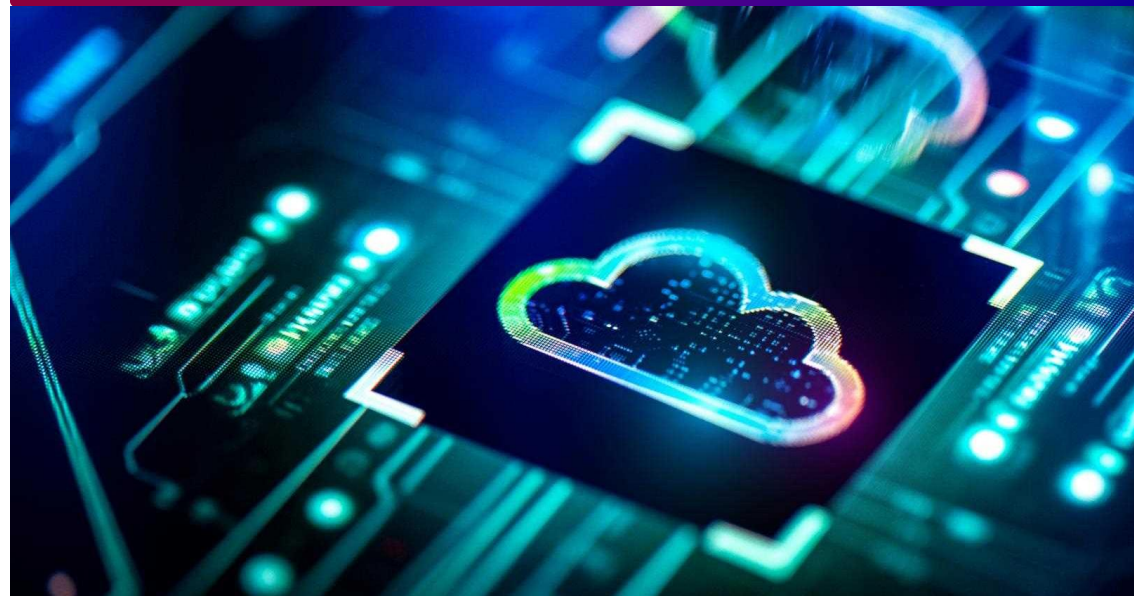
智慧穿戴



- 相關裝置逐步導入AI功能，且以“輕薄短小”為主要研發方向，驅動硬體規格升級，帶動客戶對於高層數、細線路等高階產品的需求持續成長。

2025 年泰國新產能開出，將能有效承接伺服器、車載與光通訊等高成長應用領域的客戶需求

AI 伺服器



- 由通用型伺服器成功切入AI伺服器領域，通過對於關鍵製程的掌握，獲得AI伺服器穩定訂單提供營收成長動能。
- 擴大與客戶在Intel/AMD/ASIC 三大架構案件開發。
- 配合現有兩大雲端客戶AI ASIC相關產品發展規劃。

光通訊



- 去年陸續通過客戶認證後已進入量產，今年以800G/1.6T高階mSAP設計為主，將新增更多客戶與訂單，3.2T產品也開始進入研發設計階段。
- 隨AI持續深化發展，高階產品需求增長以mSAP需求為主力，未來3-5年保持高成長性。

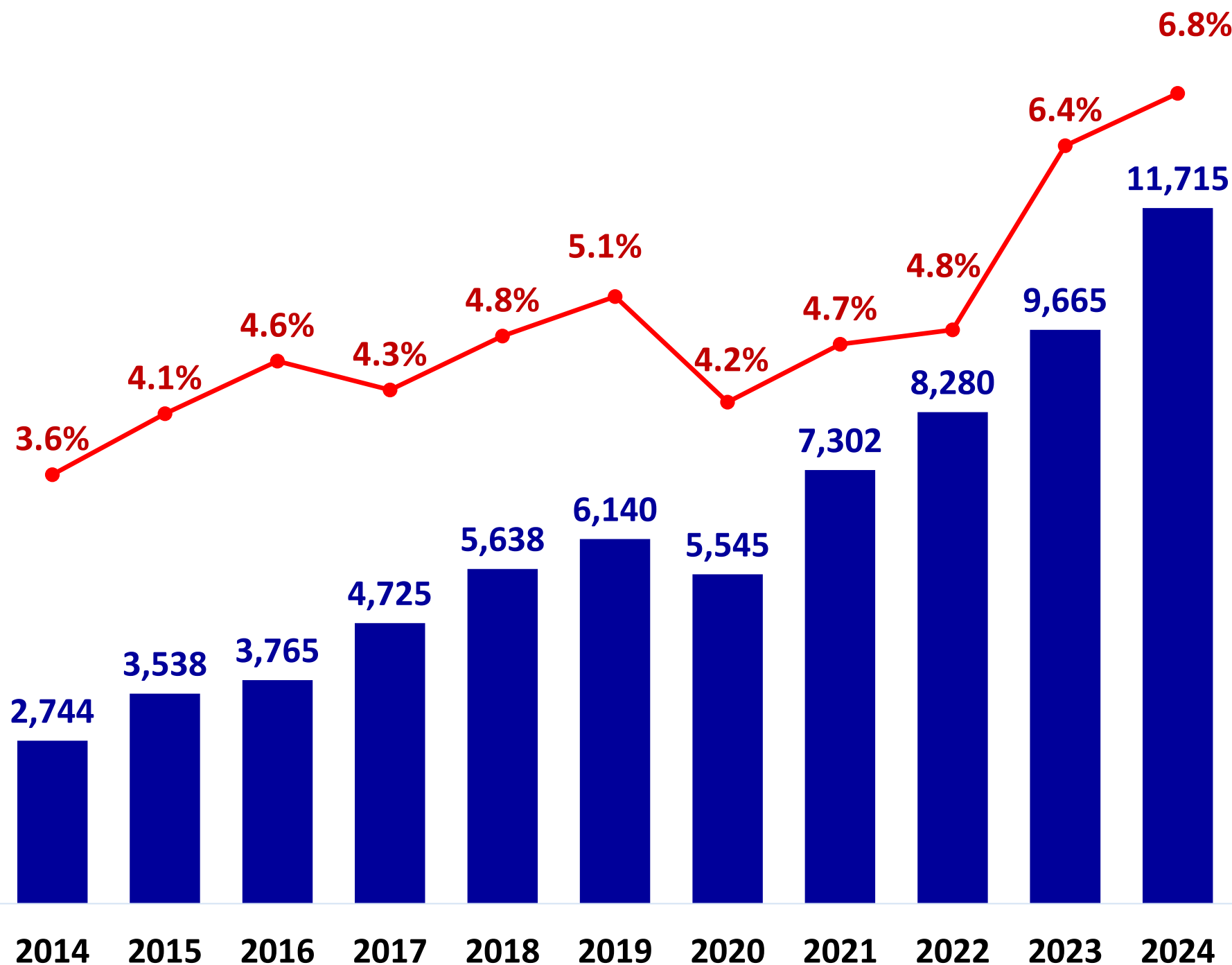
車載



- 積極布局汽車智駕化高階多層HDI 產品，ADAS 域控主板及高階傳感器已量產。
- 電動化部分，動力電池相關產品出貨量持續成長。
- 車用互聯化部分也隨客戶開發，將會有高階SLP應用出現。

持續投入高階產品研發，鞏固產業領導地位

■ 研發費用 ● 研發費用佔營收比例 (%) 單位：新台幣百萬元



在印刷電路板和半導體相關開發計畫上，臻鼎遵循12字方針，研發高階技術並引入到各項具有前瞻性之領域應用中。

12字方針：

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| 輕 輕型化 | 薄 薄型化 | 短 流程短 | 小 小型化 |
| 高 高頻、
高速、
高散熱 | 低 低污染、
低成本、
低功耗 | 多 多功能、
多層 | 快 快速研發、
快速製造 |
| 精 公差精進 | 美 美觀 | 細 細線路 | 智 智能化 |

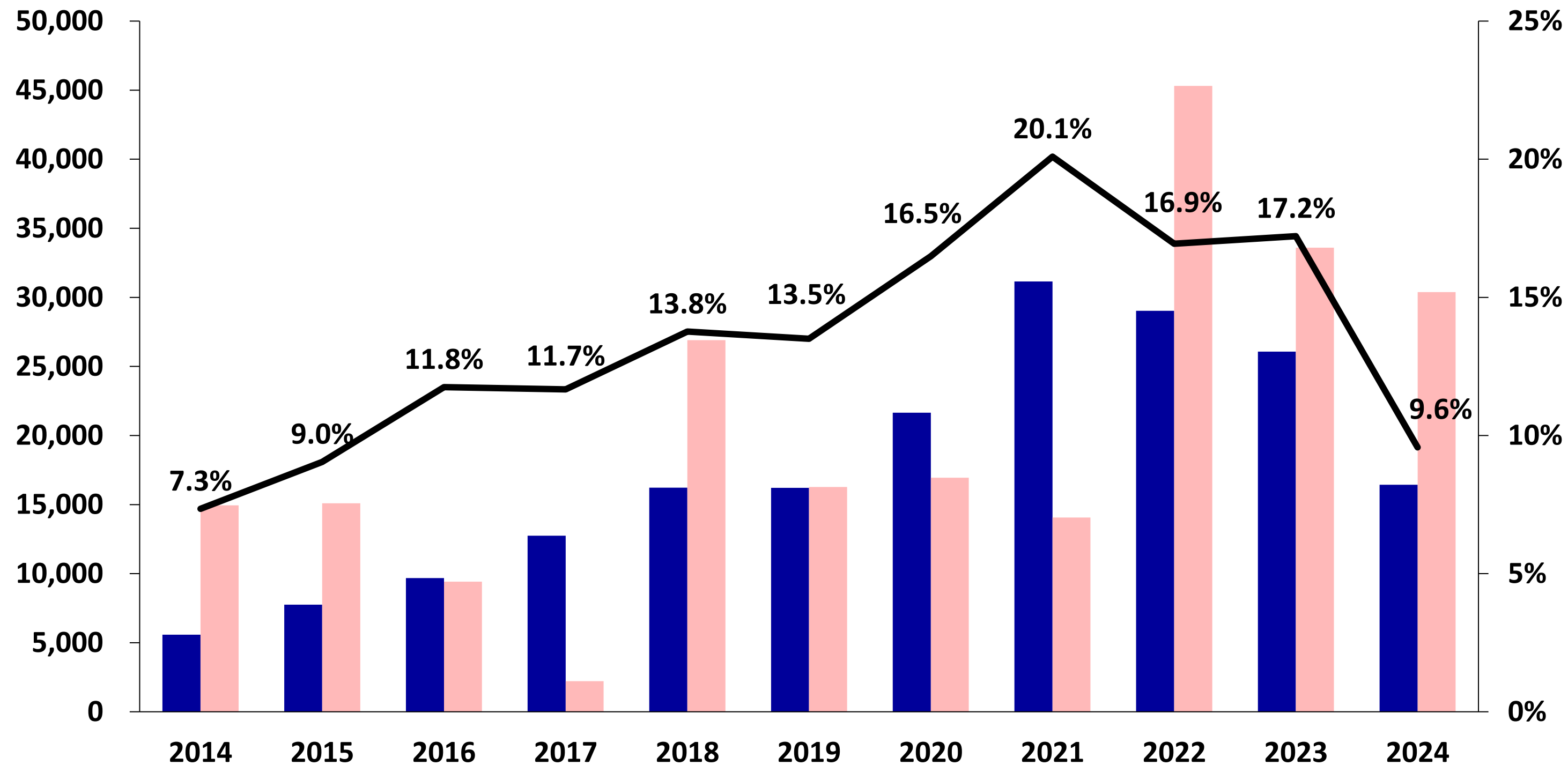
實施台灣及大陸雙研發中心，持續提升新技術開發能力，以保持高端產品及技術之領先優勢。

擴產有依，穩健前行，
搶占市場先機

以強勁的現金流審慎支應資本支出， 穩健面對總體環境變化

單位：新台幣百萬元

■ 資本支出 ■ 來自營運之現金流量 — 資本支出/營收 (%)



擴產規劃



大陸廠區

- 2025年將擴充車載、儲能軟板產能，亦將配合客戶建置去瓶頸所需高階產能。



泰國巴真府廠區

- 第一期已於2月開始進機，於5/8試產、下半年小量產，同時第二期廠房亦於5/8動土。
- 第一期產能將以高階伺服器/車載/光通訊相關應用為主，提供高階RPCB/HDI產品。



高雄AI園區

- 預計投入新台幣80億元購置IC載板生產設備，建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域。
- 預計投入新台幣20億元購置HDI+HLC PCB 生產設備。
- 軟板產線已進入試產。

提升營運效益之策略

- 各廠區分階段導入智慧工廠與數位轉型，提升營運效率，確保單位人均產值有效提升，進一步提升整體獲利率。
- 生產中高階RPCB/HDI產品，應用於伺服器、車載、光通訊，有助於提升毛利率。
- 積極投入資源、開拓新產品，爭取在產能投產後切入更多一線客戶。
- 規劃生產超高階產品(30L~80L)。
- 預計於2026年初陸續開始客戶認證。

多元生產基地建置高階產能，滿足全球客戶需求

印度



清奈園區

FPC先進模組



泰國



巴真府園區

預計5/8試產

大陸 深圳



深圳第一園區

FPC與先進模組/HDI



深圳第二園區

FPC先進模組

大陸 秦皇島



秦皇島園區

FPC與先進模組/
SLP高階 HDI

大陸 淮安



淮安第一園區

RPCB/HDI



BT載板園區

FC-CSP/WB-CSP/
Memory，第一期
2022年量產



淮安第二園區

FPC與先進模組/
HDI/Mini LED 背光
超薄細線路電路板



淮安第三園區

高階 HDI/MSAP，
2023年量產

台灣



高雄AI園區

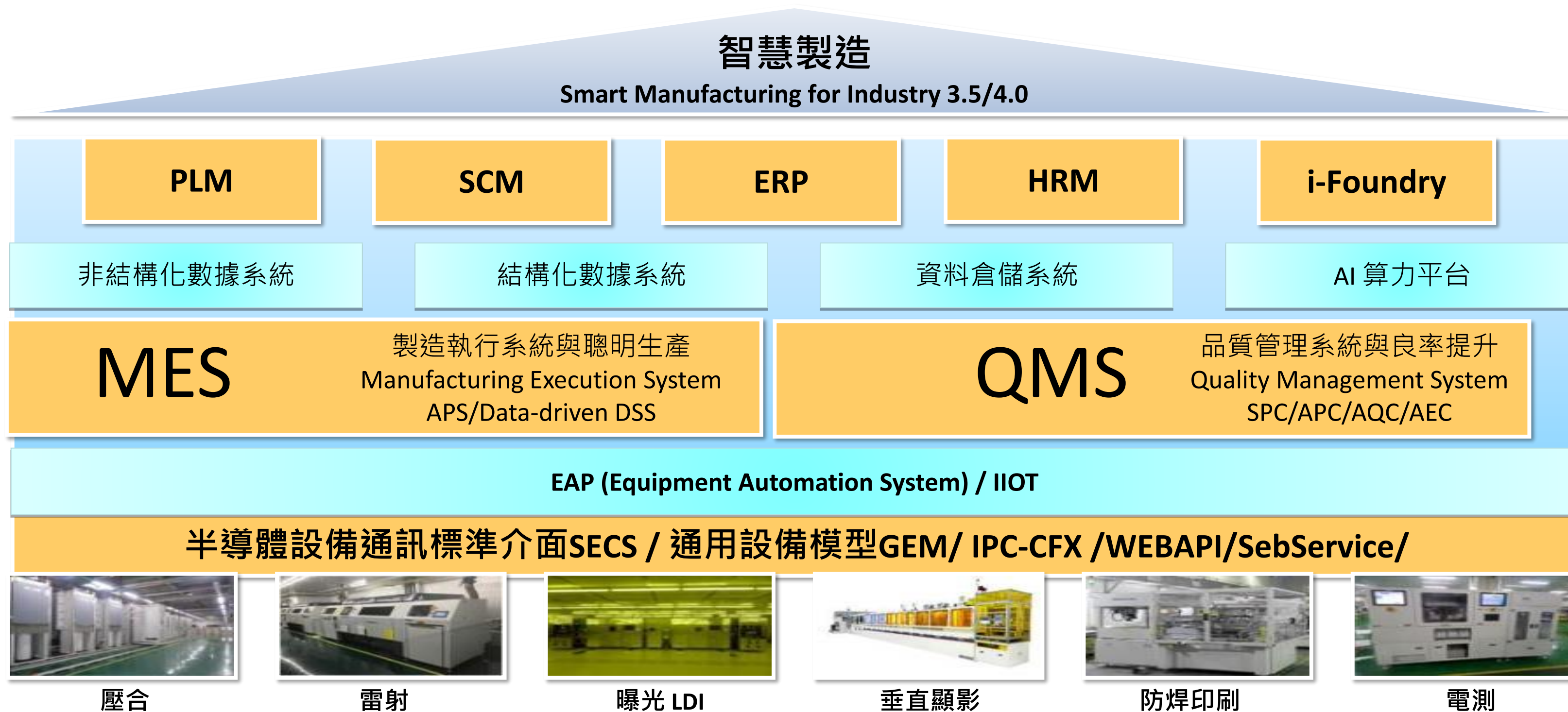
AI產品之研發暨生
產據點



ABF載板園區

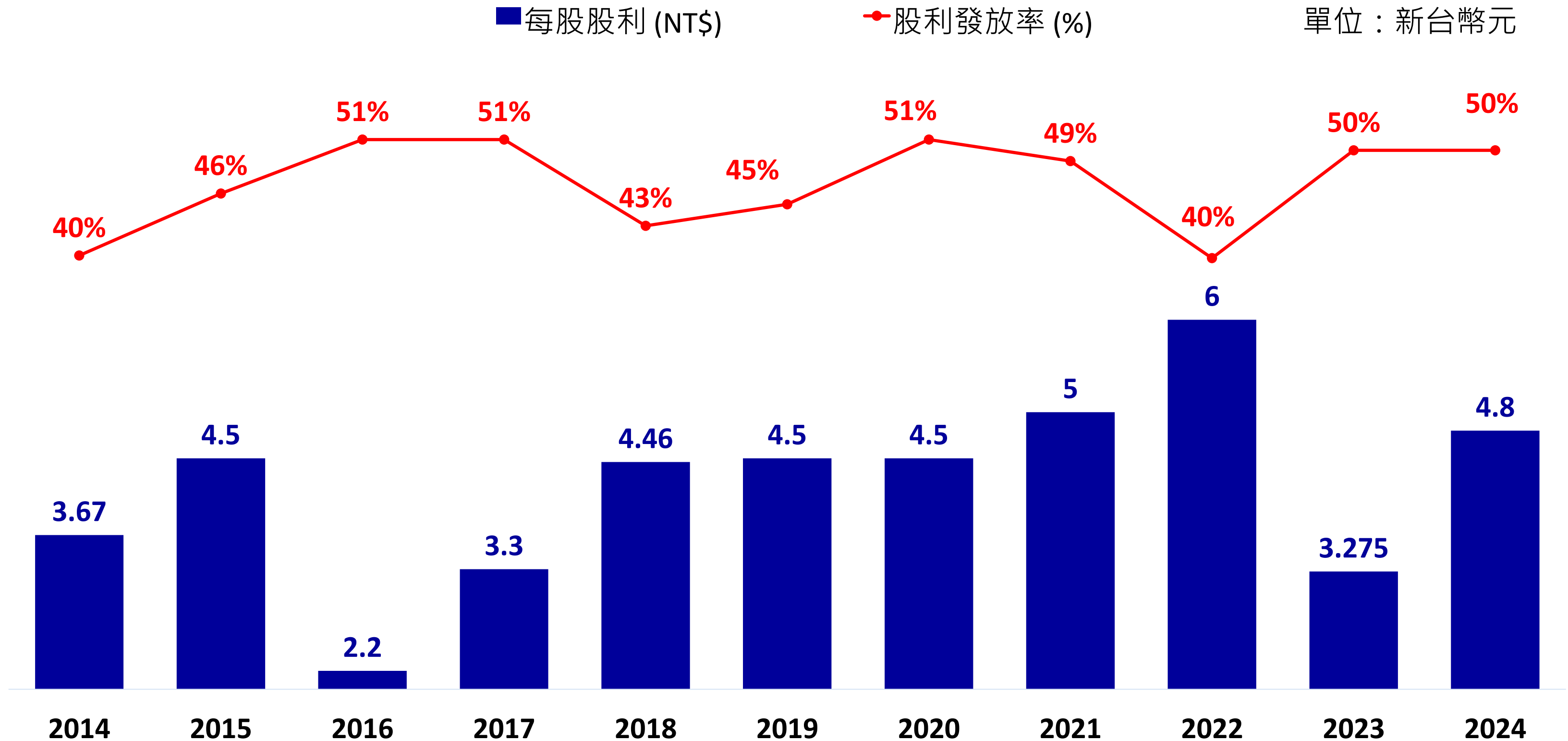
第一期2023年量產

透過智慧製造，提高人均產值，創造更佳獲利



作業數位化、數位平台化、平台智能化、智能實戰化

維持高股息發放率，與股東共享經營成果



▶ 臺灣公司治理評鑑

2024年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度入選臺灣證券交易所公司治理100指數。

▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2024年S&P Global ESG 評級進步至78分，連續3年入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)，為台灣唯一入選的PCB企業。

▶ Sustainalytics ESG 風險評級

最新Sustainalytics ESG風險評級為15.7，為低等風險等級。

▶ ISS ESG 評級

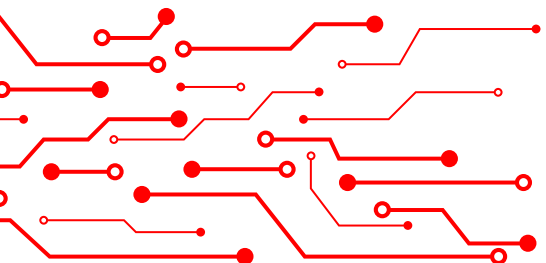
最新年度的ISS ESG評級由「C」進步至「C+」，獲得「優秀(Prime)」等級。

▶ CDP 碳揭露專案

2024年在水安全管理獲得「A」最高等級殊榮，較去年進步一等級。在氣候變遷獲得「B」等級。

▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.4分（滿分為5分），成為台灣上市櫃公司並列第五名。



營運成果摘要

第一季營運成果

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	1Q25	1Q24	年變化 (%)
營業收入	40,082	32,510	+23.3%
營業毛利	5,885	5,337	+10.3%
營業毛利率	14.7%	16.4%	-1.7ppts
營業費用	4,829	4,594	+5.1%
營業利益	1,056	743	+42.2%
營業利益率	2.6%	2.3%	+0.3ppts
營業外收入及支出	401	755	-46.9%
本期淨利	1,025	1,436	-28.6%
淨利率	2.6%	4.4%	-1.8ppts
歸屬於母公司之淨利	632	977	-35.3%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	0.66	1.03	
研發費用	2,563	2,634	-2.7%
折舊及攤銷	4,739	4,231	+12.0%
營運活動之現金流入	11,144	8,257	+35.0%
現金及約當現金 ⁽²⁾	85,879	72,995	+17.7%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	2.7%	4.2%	-1.5ppts

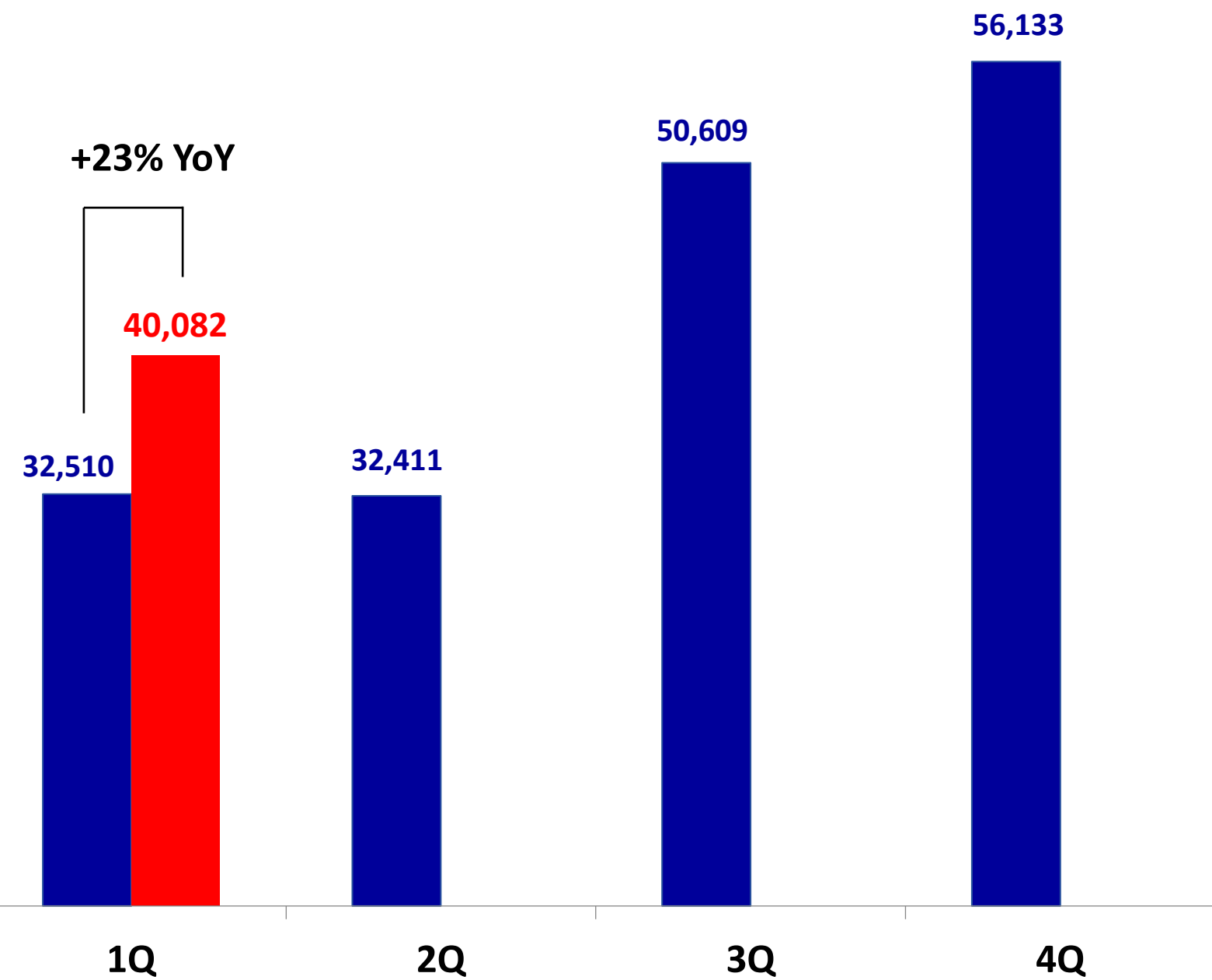
附註：(1) 2025年第一季加權平均流通在外股數為954,559仟股 (實際發行股本956,652仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

季度營運成果

營業收入

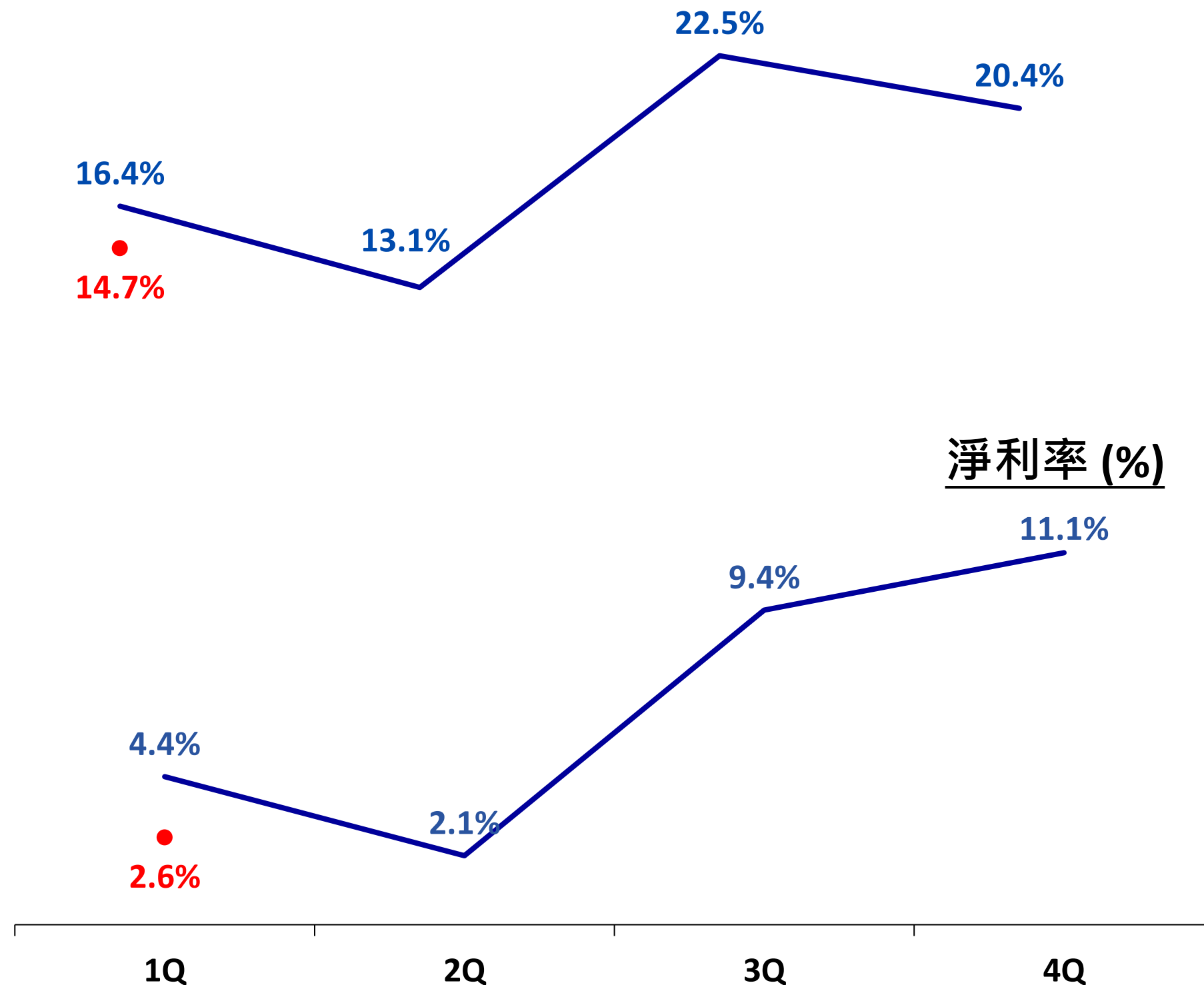
■ 2024 ■ 2025

單位：新台幣佰萬元



毛利率 (%)

— 2024 — 2025



淨利率 (%)

4.4%

2.6%

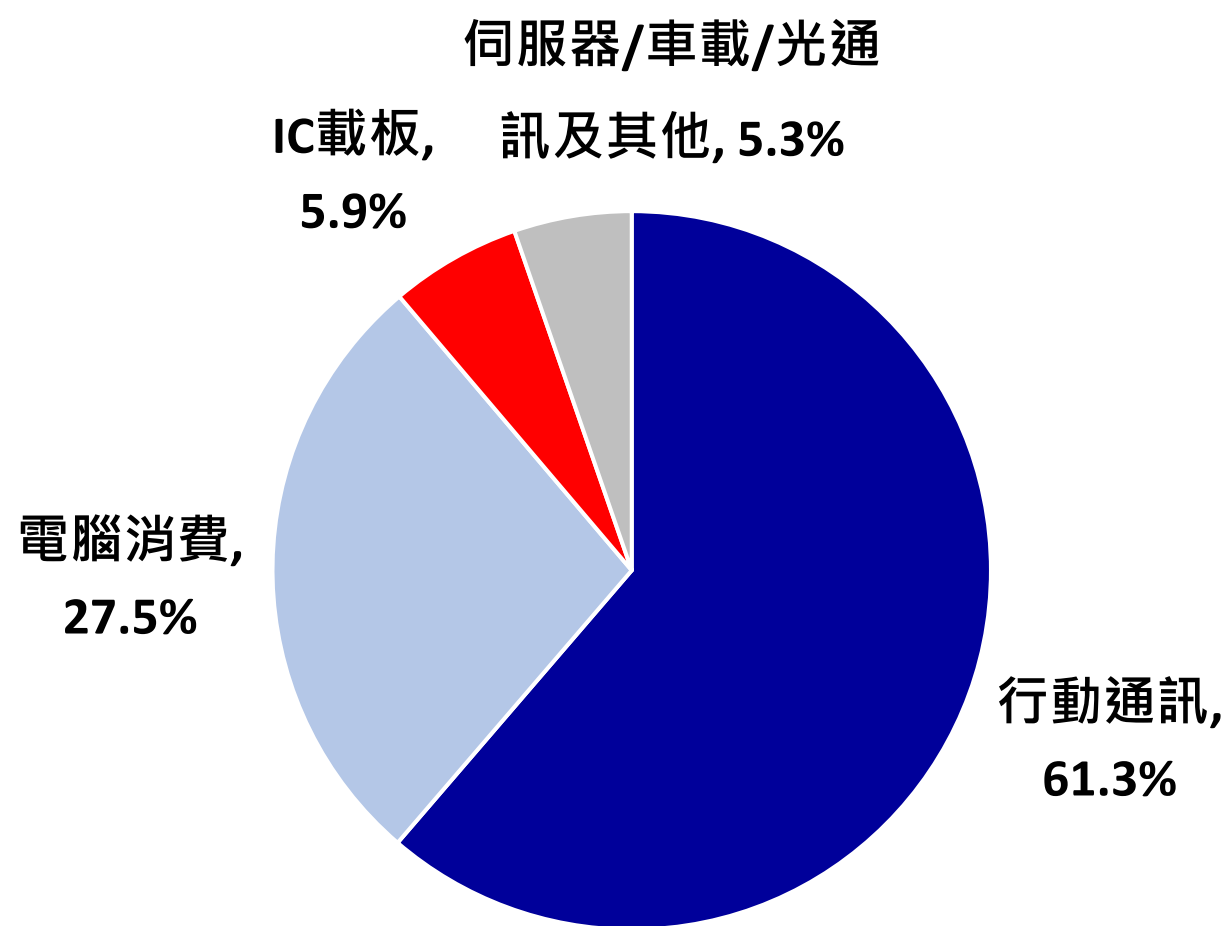
2.1%

9.4%

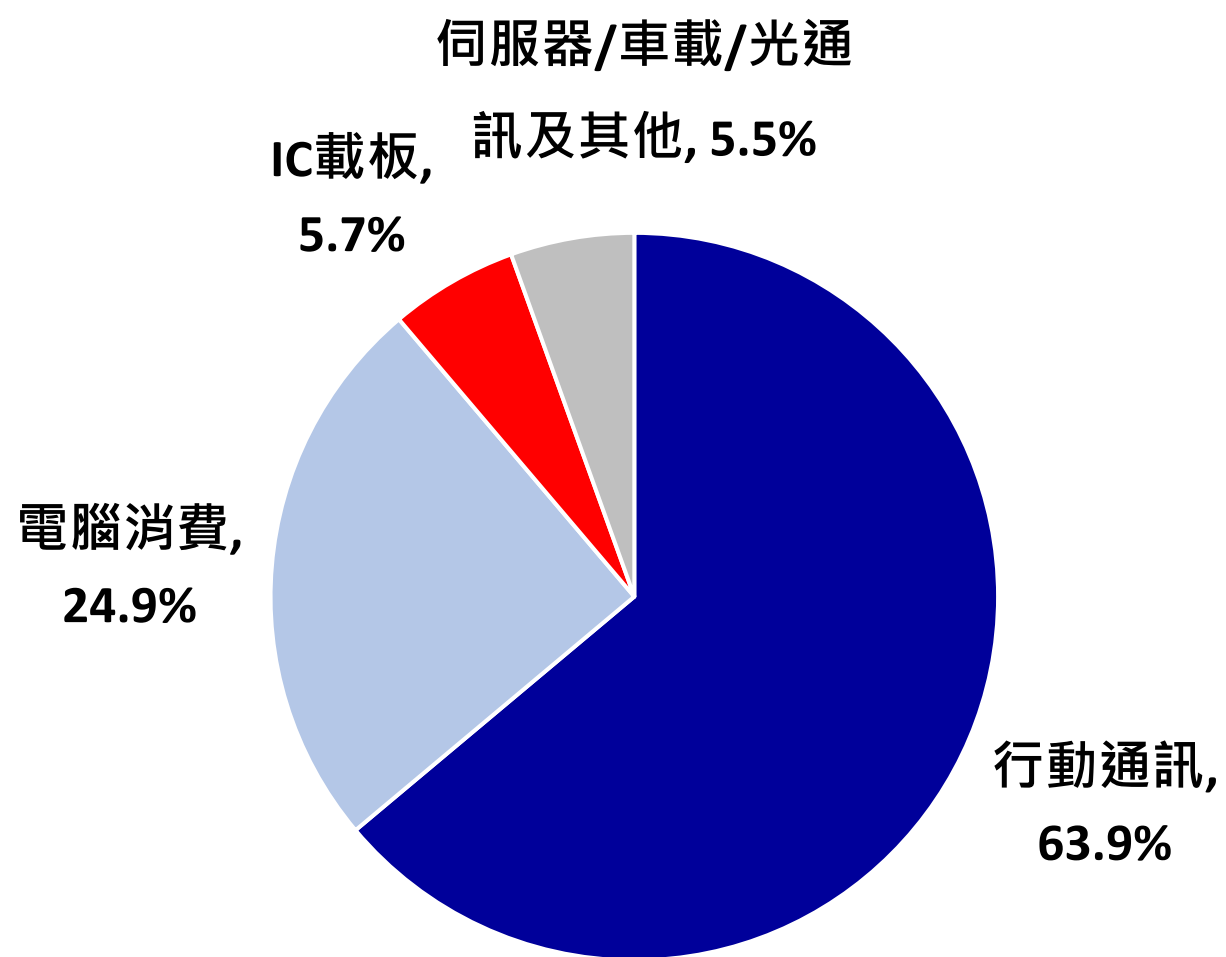
11.1%

銷售分析-產品應用別

1Q25營收：新台幣401億



1Q24營收：新台幣325億



產品別	1Q25營收YoY%
行動通訊	+18.4%
電腦消費	+36.2%
IC載板	+27.2%
伺服器/車載/光通訊及其他	+18.1%

資產負債表及重要財務比率

單位：新台幣佰萬元

	2025-3-31		2024-3-31		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	85,879	32.3%	72,995	30.0%	12,884	+2.3ppts
應收款項	22,676	8.5%	20,856	8.6%	1,820	-0.1ppts
存貨	16,780	6.3%	15,858	6.5%	922	-0.2ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	115,397	43.4%	110,806	45.5%	4,591	-2.1ppts
資產總額	265,744	100.0%	243,283	100.0%	22,461	
借款	58,910	22.2%	54,143	22.3%	4,766	-0.1ppts
應付款項	40,893	15.4%	33,230	13.7%	7,663	+1.7ppts
負債總額	114,757	43.2%	104,632	43.0%	10,125	+0.2ppts
股東權益總額	150,987	56.8%	138,652	57.0%	12,335	-0.2ppts
重要財務比率						
平均收現日數(天)	60		70		(10)	
平均銷貨日數(天)	49		57		(8)	
流動比率(倍)	1.75		1.82		(0.07)	
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.40		1.18		(0.22)	

附註：(1) 2025年第一季加權平均流通在外股數為954,559仟股 (實際發行股本956,652仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 不動產、廠房及設備 包含 投資性不動產。(4) 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

歷年營運成果

單位：新台幣佰萬元

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
營業收入	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398	171,664
營業毛利	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459	32,461
本期淨利	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432	13,096
母公司淨利	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189	9,180
折舊及攤銷	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323	17,749
每股盈餘 (元)	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.55	9.67
每股股利 (元)	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275	4.80
分派比率 (%)	46%	51%	51%	43%	45%	51%	49%	40%	50%	50%
現金及約當現金 *	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970	79,830
不動產、廠房及設備	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965	113,462
資本額	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470	9,567
股東權益報酬率 (%)	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%	9.15%
負債比率 (%)	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%	42.85%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



Thank You